



Department: Regional Innovation Centre for Electrical Engineering

Research reportno.: 22190 - 088 - 2013

Vibrační test pružných kontaktů modulu MiniSKiiP

Type of task: Scientific research

Researcher(s): Doc. Ing. Pavel DRABEK, Ph.D.

Ing. Bedrich BEDNAR

Ing. Jan STEPANEK

Head of task: Doc. Ing. Pavel DRABEK, Ph.D.

Number of pages: 10

Date of issue: December 2013

Revision: 1

Note: The content is a subject of a trade secret.

Anotace

Tato výzkumná zpráva se zabývá ověřením technických parametrů pružných kontaktů používaných v pouzdrech výkonových polovodičových modulů SEMIKRON, série MiniSKiiP. Zpráva popisuje pracovní postup pro zkoušku modulů na dlouhodobém vibračním testu.